

## EZReball™ (植球预制片) 技术数据

### 预制片

预制片选用的材料性能使其能用激光加工并可提供各种不同的厚度。这种材料还能在非常宽广的温度范围内仍保持其物理、化学及电学方面性能的平衡。而且，在非常宽广的温度范围内仍能保持其形状尺寸的稳定性。这些性能使该材料成为理想的选择。

抗张强度： 23°C 下 >31,800PSI (2237kg/cm<sup>2</sup>)

200 °C 下 >33,300PSI (2343kg/cm<sup>2</sup>)

伸长率： 23 °C 下 <57%, 200 °C 下 <85%

弹性模量： 23°C 下 >274 KPSI ( )

200 °C 下 >239 KPSI ( )

热膨胀系数： 20 ppm/°C (20 X10<sup>-6</sup>/°C)

玻璃化转变温度： 351 °C

400°C 下的尺寸稳定性： 小于 0.40%

吸湿度： 最大 4%

导热系数： 0.17 W/mK (170 W/°C)

UL 认证等级： UL 94V0

胶粘带：

所使用的胶粘剂具有很好的抗溶性能。这种胶粘剂用于高温下一般附着或绝缘（最高温度为摄氏 155 度）。它的边缘抗撕裂性能非常好。

绝缘级别： 155 °C

底衬材料： 玻璃布

胶粘剂： 丙烯类（亚克力）加热即硬化的抗溶材料

颜色： 白色

总厚度： 7 密尔（0.178 毫米）

与钢之间的粘接强度： 每英寸 45 盎司/每厘米 502 克

抗张强度： 每英寸 180 磅/每厘米 32.2 公斤

介电强度： 3,000 伏

延长度： 7%

UL 成分认可： Guide OANZ2, File E20392

符合标准： MIL-T-4053B （美军标）

焊接锡球

EZReball™（植球预制片）工艺使用的焊接锡球用原材料制造，以满足或超越对建立或修理半导体工件的要求。它们在纯度和尺寸偏差方面均超过 IPC 和 MIL 标准。所使用的焊球具有高的园度和尺寸精确度。

第 5 步 - 使用您的原有流程熔焊 BGA。

第 6 步 - 从 BGA 上移去 EZReball™（植球预制片）。

您在焊接返修/维修、焊接培训以及焊接工具领域内的**顶好**选择。

[www.solder.net](http://www.solder.net)

BEST（顶好公司）

3603 Edison Place, Rolling Meadows, IL 60008

电话：1-847-797-9250 传真：1-847-797-9255